二维半导体三维集成研究取得新成果

作者：writer 来源：中国科学院

本文原地址：https://www.iikx.com/news/progress/27574.html

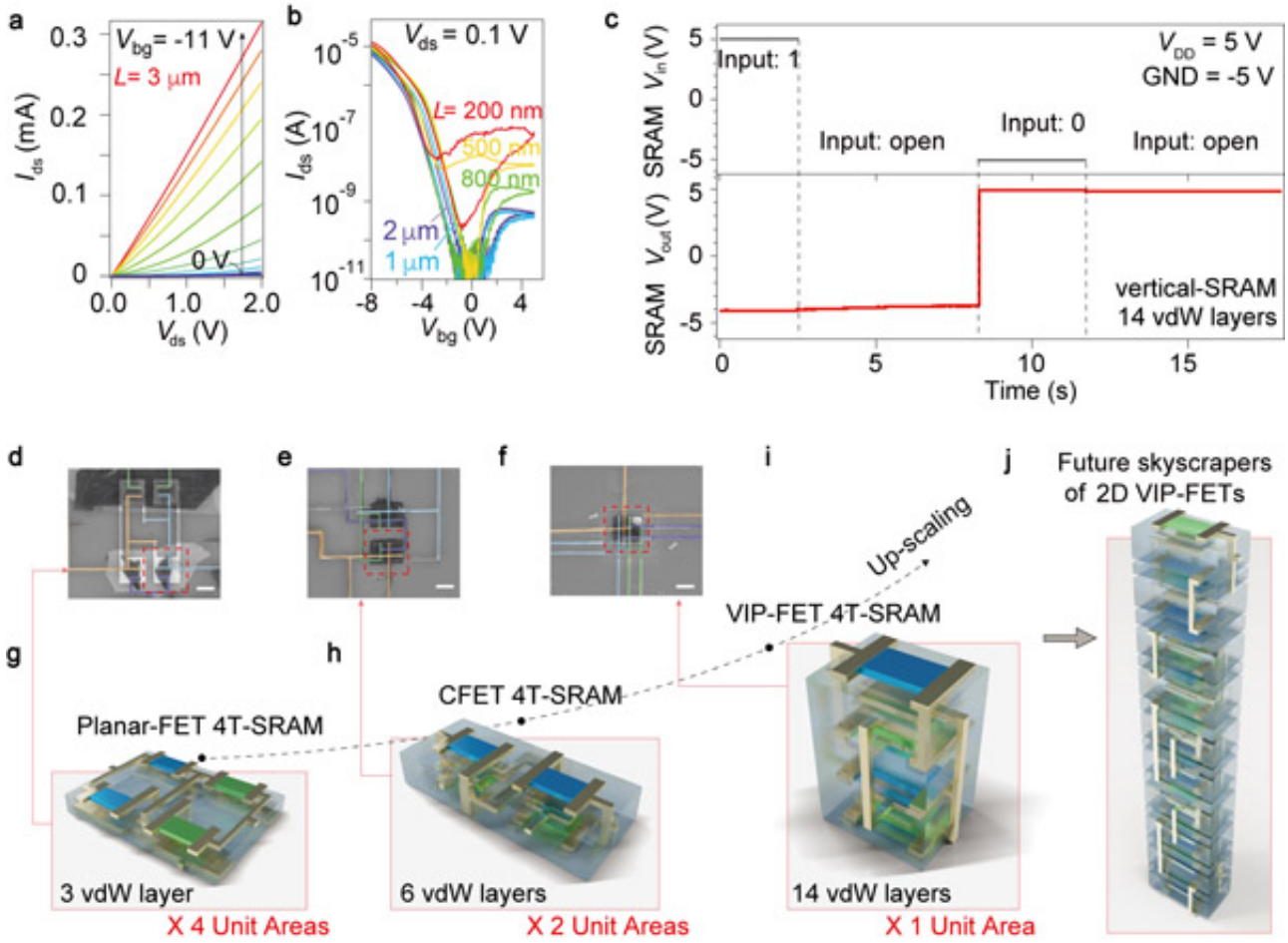
本文仅供学习交流之用，版权归原作者所有，请勿用于商业用途！

二维半导体三维集成研究取得新成果。

经过数十年发展，半导体工艺制程不断逼近亚纳米物理极限，但传统硅基集成电路难以依靠进一步缩小晶体管面内尺寸来延续摩尔定律。发展垂直架构的多层互连CMOS逻辑电路，从而获得三维集成技术的突破，是国际半导体领域积极探寻的新路径之一。

5月29日，相关研究成果以*Van der Waals polarity-engineered 3D integration of 2D complementary logic*为题在线发表在《自然》（*Nature*）上。研究工作得到国家重点研发计划纳米专项、国家自然科学基金以及沈阳材料科学国家研究中心、辽宁材料实验室、山西大学量子光学与光量子器件国家重点实验室等的支持。

论文链接



二维半导体三维集成研究取得重要进展

研究团队单位：金属研究所

更多 科学进展 请访问 https://www.iikx.com/news/progress/

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，爱科学iikx.com转发